



1 **반도체 IR Conference 참여기업 개요**

| No. | 회사명 | 설립년도 | 주요 제품 | 구분 |
|-----|------------|------|--|---------|
| 1 | 코스텍시스템(주) | 2000 | 웨이퍼 본더 & 디본더, 웨이퍼이송장치, Dry Asher, Descum | Group A |
| 2 | 엠텍비전(주) | 1999 | CDR, DSM, UBI, GPS, IC, RMCU 등 | |
| 3 | 피애피네트웍스(주) | 2000 | 전 세계 자동차용 디지털라디오 수신 칩(SoC) (DAB, HD Radio, DRM, CDR) | |
| 4 | (주)코마테크놀로지 | 2014 | Si Ring, Sapphire 노즐 외 반도체 공정 부품 | Group B |
| 5 | (주)피티에스 | 2009 | RF 전원장치, RF 매칭박스, 주변장치 | Group C |
| 6 | (주)시술 | 1973 | NFC리더/ 모듈/ 결제단말/ 지문인식카드 | |
| 7 | (주)와이젯 | 2015 | 60GHz 무선기술기반 무선 영상 전송장치 | |
| 8 | (주)모르미 | 2018 | 병렬처리 프로세서 | |
| 9 | 아이칩(주) | 2015 | Eyechip™(Eyeball Sensor Chip), Eyechip™ Camera Modules & Eyechip™ Solutions | |
| 10 | 지엘에스(주) | 2017 | 60GHz 초고속 근접 무선통신 칩셋 및 관련 통신 솔루션 | |

* Group(매출액) : **A** - 50억원~200억원, **B** - 20억원~ 50억원, **C** - 20억원 미만

2

참여기업 주요 사업내용

1. 코스텍시스템(주)

▶ 반도체 제조공정용 Wafer Transfer System 및 Wafer to Wafer Bonding 장비 기술 분야 국내 1위

- 반도체/uLED용 웨이퍼 본더 & 디본더 및 uLED 전사장비 기술 보유 기업 (웨이퍼 본딩 & 디본딩 기술 특허 보유 국내 1위 기업 / 수요기업인 SK하이닉스와 공동 개발) - 삼성전자에 uLED 전사장치 공급, Nepes에 Fan-out Wafer Level Packaging용 웨이퍼 본더 & 디본더 장비 공급
- 반도체 웨이퍼 이송용 Vacuum Chamber 기술, 초정밀 반도체 Wafer 이송용 Robot기술이 적용된 Backbone(Vacuum Cluster Tool)을 반도체 전공정 장비 기업인 원익IPS를 통해 삼성전자에 납품한 국내 시장 점유 1위 기업. (2016년 산자부 R&D지원 사업인 우수기술연구센터(ATC) 사업자로 지정)
- 일본 FOI사의 Plasma Etching 기술을 인수하여 Light Etching 분야인 Dry Asher, Descum 장비를 중국, 대만에 수출을 추진 중

2. 엠텍비전(주)

▶ 이미지 프로세싱 및 인식기술 기반의 전문 반도체와 Total Solution 제공

- CDR(블랙박스)과 IoT를 접목한 UBI(Usage Based Insurance) 블랙박스, GPS제품 국내 최초 출시 및 FMS(Fleet Management System) 시장 진출
- NXP의 자율주행 Platform의 ISP개발 파트너 및 DSM(운전자감지시스템) 상용화 기업(국내, 일본, 중국 수출 중)
- Deep Learning기반의 In-Cabin Camera 개발 진행 중(국책과제)

3. 피애플네트웍스(주)

▶ 전 세계 자동차용 디지털 라디오(DAB, HD Radio, DRM, CDR)수신 칩 전문

- 전 세계 유일한 디지털라디오 수신칩만을 공급하는 회사로 어느 회사의 아날로그 라디오(AM/FM) 칩과도 인터페이스가 되어 같이 사용할 수 있으며, ST마이크로, 파나소닉, AKM와는 전략적 협력 중(DAB : '17년 시장점유율 23%)
- SDR(Software Defined Radio) 기술개발 및 양산적용
 - DSP을 이용한 SDR기술개발로 DAB/HD Radio/DRM을 One-PCB로 지원
 - DAB/HD Radio/DRM뿐만 아니라 CDR도 지원할 수 있는 SDR 기술 개발
 - 다양한 디지털 라디오의 SW개발 및 SW품질 보증을 위한 기술 확보
 - Zero ppm만족을 위한 자동차용 반도체 설계, 생산 및 품질관리
- 독일의 하만베커와 비스테온을 통해 Audi, BMW, Volkswagens, Ford, Chrysler, Reno/Nissan, GM 등의 자동차 업체에 2010년부터 현재까지 공급 중
- 인도의 DRM은 2015년부터 현대자동차에 판촉을 시작하여 현재 현대모비스와 LG가 현대자동차 2019/20년 모델에 적용하기 위하여 개발 중
- 북미의 HD Radio는 2017년부터 Ford, FCA, GM, Tesla에 판촉을 시작하여 하만(삼성), 비스테온, 파나소닉과 2020/21년모델에 적용하기 위하여 검토 중

4. (주)코마테크놀로지

▶ 반도체 공정부품 제조 전문기업

- (Silicon Ring) 반도체 제조 공정 중 가장 많이 소요되는 공정 소모품으로 지속적으로 수요가 늘어나고 있는 부품이며 현재 국내 3대 제조사(S, W, H) 거래
- (Sapphire Nozzle) 기존 세라믹 AlN, Al₂O₃, Quartz 소재의 가스 인젝터, 노즐을 국내 최초로 Sapphire 소재 변경을 통한 효율성 극대화(5배 이상의 수명), H社 청주 공장 적용 및 주요 부품 개발 지속 진행
- (Quartz, Ceramic parts) 반도체 장비 공정 부품 중 Quartz, Ceramic parts 제조, 다양한 소재의 공정 부품을 가공하고 있으며 이로 인한 가격, 품질 경쟁력 확보

5. (주)피티에스

▶ 플라스마용 RF 전원장치 및 RF 매칭박스 전문기업

- 일본 RF 전문 기업인 NRF의 기술력을 AMP 기술을 이전받아 경쟁사 대비 다양한 주파수 및 최고출력대응이 가능한 기업으로, 독자 기술 확보
 - 400kHz, 2MHz, 4MHz, 13.56MHz, 27.12MHz, 40.68MHz, 60MHz, 100MHz
 - 300W~100kW 출력
- 삼성전자, SK하이닉스, 삼성디스플레이 주요 End user로 다수의 장비회사에 양산 적용 및 평가 실적 보유
- 경쟁사 대비 비교우위의 옵션 사항 보유
(Vpp/Vdc, Irms, Pulse, Arc cut management, Handy controller)

6. (주)시솔지주

▶ NFC Reader기 개발 및 스마트카드 제작

- 시솔은 결제시스템 개발회사에 NFC 모듈공급 및 이를 위해 요구되는 모든 NFC Application(결제, 물류관리 등)의 Consulting을 하며, 주요 파트너 및 고객회사는 엠텍비전(NFC chip maker), PAYCO, LG디스플레이 등이 있음
- **(SDCP-I)** 기존 높은 가격대의 NFC reader를 대체할 저렴하고 단순하게 비접촉식 카드 및 NFC 결제를 가능하게 해주는 NFC Intelligent Card Reader로 Windows 기반의 POS장치나 터미널뿐만 아니라 안드로이드 기반의 태블릿이나 스마트폰과도 간편하게 USB로 접속결제가 가능(단순 UID READER로도 이용 가능)
- **(무전원 지문인식카드)** 기존 제품과 달리 NFC reader의 자기장으로 배터리 없이 지문인식 가능하여 반영구적으로 사용가능하며 쉽고 빠른 사용이 가능함. FIDO U2F와 연계 가능하도록 설계되어 추후 온라인구매 및 바이오 암호화를 통한 개인정보 차단 및 강력한 보안시스템으로 활용가능
- **(조립형 멀티패드)** 기존 단말기에서 IC카드 결제기의 고장발생시 전체 단말을 사용하지 못하게 되는 불편함을 최소화 하고자 소켓형 조립식 단말연결로 쉽고 빠른 교체 (AS최소화)가 가능. 선택적 연결로 사용자 편리성 및 비용절감 및 추후 새로운 결제방식으로의 요구에 따라 확장 가능한 제품

7. (주)와이젯

▶ 60GHz 무선기술 기반 무선 영상 전송장치

- 스마트폰, 노트북, 가상현실, 의료영상기기 등에 사용되는 4K UHD급 초고 화질 영상을 60GHz RF 기술을 사용하여 무지연/ 무버퍼링/ 무압축 방식으로 무선 전송이 가능한 핵심 CMOS RF SoC 기술을 개발하고, 이를 활용한 무선 송수신 제품을 개발
- 4K UHD 60GHz RF SoC
- 의료장비, 노트북/PC, 스마트폰, AR/VR, Smart Glass용 무선전송 제품 사업화

8. (주)모르미

▶ Fully Programmable Parallel Processor 개발

- 프로세서 연산속도 경쟁에서 CPU는 코어수가 많은 GPU에 연산 주도권을 넘겨줌. 이에 따른 INTEL 사의 고민은 증가하고 있음
- CPU 제조사가 연산 주도권을 GPU 로부터 다시 가져오려면,
 - 병렬처리 CPU Architecture
 - 병렬처리 S/W 통합 플랫폼
 - GPU를 능가할 수 있는 CPU 연산효율을 구현이 필요
- (주)모르미는 이론적으로 병렬처리가 가능한 “한주기 이론”을 개발하고 이에 부합하는 한주기 병렬처리 프로세서(EOPPP)를 개발함
- EOPPP는 S/W Code 100%를 병렬처리하고, 연산성능이 코어 수에 비례하며, GPU를 능가하는 연산효율로 연산주도권을 GPU로부터 다시 가져올 수 있음은 물론 Legacy S/W와 호환이 가능한 “한주기 병렬처리 프로세서”

9. 아이칩(주)

▶ 눈동자 위치 추적 기술을 이용한 새로운 입력 장치용 반도체 칩 전문 기업 (아이칩(안구 센서 칩), 아이칩 카메라모듈 및 아이칩 솔루션)

- 아이칩(Eyechip™)은 눈동자 촬영과 눈동자 위치 획득 알고리즘 기능을 하나로 통합한 세계 최초의 CMOS Image Sensor Chip
- 하나의 반도체칩을 활용한 눈동자 위치 추적기술로 한국, 미국 특허 및 상표권 보유
- 아이칩(Eyechip™)을 이용하여 사용자 눈동자의 위치를 파악하여 현재 응시하고 있는 위치를 알려줌으로써 새로운 입력 장치(New input device)로 활용 가능
- Smartphones/accessories, Smart Glass, VR/AR, Wearable 기기, 게임, 보안, 의료, 시장 조사 및 군사 등 다양한 산업에 입력장치로 응용 가능함
- 미래에 혁신적인 새로운 입력장치의 개발 및 다양한 산업에 응용할 수 있도록 아이칩 카메라 모듈과 아이칩 솔루션의 연구 개발 중

10. 지엘에스(주)

▶ 세계 최초로 초고속 근접통신을 지원하는 Chipset을 개발한 고속 무선통신 반도체 솔루션 전문기업

- 세계최초 초고속 근접 무선통신규약 IEEE 802.15.3e를 지원하는 chipset 개발
 - 차세대 초고속 무선통신 규약을 지원하는 chipset을 세계최초로 개발
 - 유선 고속통신보다 2~3배 빠른 무선 데이터 전송속도를 보장(3.5 Gbps)
- 모바일 디바이스의 유선 컨넥터를 무선으로 대체
 - Smartphone 및 Tablet에서 유선 컨넥터를 무선화
 - 세계 유수의 모바일 디바이스 업체에서 채택 협의 중
 - 무선으로 영화 한편을 다운받는데 5초 이내 소요
- 60GHz 비면허대역을 사용하여 경제성 확보
 - 20/70/80GHz의 면허대역을 사용하지 않음으로써 무선통신 사용에 제약이 없고 추가 비용 발생. 근접통신에 따른 보안이 우수
 - Toshiba/Sony 등에서 2020년 개발을 목표로 하고 있는 점을 감안할 때, 최소 2~3년의 경쟁 우위를 가짐